

ICS 31.040.30

L 15

备案号:



中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 11278.4.2—2014

电子设备用压敏电阻器
第4部分：分规范
片式压敏电阻器

Varistors for use in electronic equipment-
Part 4: Sectional specification
for chip varistors

2014 - 10 - 14 发布

2015 - 04 - 01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

电子设备用压敏电阻器系列标准分为以下规范:

GB/T 10193—1997《电子设备用压敏电阻器 第1部分:总规范》

GB/T 10194—1997《电子设备用压敏电阻器 第2部分:分规范 浪涌抑制型压敏电阻器》

GB/T 10195. 1—1997《电子设备用压敏电阻器 第2部分:空白详细规范 碳化硅浪涌抑制型压敏电阻器 评定水平E》

GB/T 10195. 2—1997《电子设备用压敏电阻器 第2部分:空白详细规范 氧化锌浪涌抑制型压敏电阻器 评定水平E》

SJ/T 11278—2002《电子设备用压敏电阻器 第3部分:分规范 防雷型压敏电阻器》

SJ/T 11279—2002《电子设备用压敏电阻器 第3部分:空白详细规范 防雷指示型过电压保护器 评定水平E》

SJ/T 11278. 4. 2—2014《电子设备用压敏电阻器 第4部分:分规范 片式压敏电阻器》

SJ/T 11278. 4. 1—2014《电子设备用压敏电阻器 第4部分:空白详细规范 片式压敏电阻器 评定水平E》

.....

本规范是根据GB/T 10193—1997《电子设备用压敏电阻器 第1部分:总规范》,并参照国内外现有片式压敏电阻器的有关技术资料以及生产、应用中积累的数据而制定的。

为了适应我国电子电气设备系统的浪涌防护及静电防护要求,补充和完善GB/T 10193—1997标准体系,特制定本规范。本规范是GB/T 10193—1997的一个分规范,与GB/T 10194—1997、SJ/T 11278—2002并行。

本规范按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本规范的附录A为规范性附录。

本规范由工业和信息化部电子工业标准化研究院归口。

本规范主要起草单位:河南金冠王码信息产业股份有限公司。

本规范主要起草人:吕呈祥、景志刚、韩长生。

电子设备用压敏电阻器

第4部分：分规范

片式压敏电阻器

1 范围

本规范规定了片式压敏电阻器的额定值、优先值、特性和质量评定程序，并补充了相关术语、试验和测量方法。

本规范适用于电子设备用片式压敏电阻器，它具有金属化焊接区，能够直接安装在混合集成电路的基片或印制板上。

详细规范中引用本规范规定的试验严酷等级和要求时应具有相同或更高的性能水平，不允许降低性能水平。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有修改单）适用于本文件。

GB/T 10193—1997 电子设备用压敏电阻器 第1部分：总规范（idt IEC1051-1:1991）

GB/T 17626.2—1998 电磁兼容 试验与测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 2421—1999 电工电子产品环境试验 第1部分：总则

GB/T 2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5—1995 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.6—1995 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Eb和导则：碰撞

GB/T 2423.29—1999 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验U：引出端及整体安装件强度

SJ/T 11167 敏感元器件及传感器命名方法

SJ/T 11200—1999 环境试验 第2部分：试验方法 试验Td：表面组装元器件的可焊性、金属化层耐熔蚀性和耐焊接热

3 术语和定义

GB/T 10193—1997确立的以及下列术语和定义适用于本文件：

3.1

片式压敏电阻器 chip varistor

一种端头的形状和结构适合在混合集成电路基片上或印制板上进行表面安装的压敏电阻器。